

Vítejte v O-lead

Jsme profesionální výrobce desek plošných spojů s více než desetiletou zkušeností. Produkty řady jedno-, dvojstranné, vícevrstvé PCB, flexibilní PCB a MCPCB. Můžeme zajistit rychlý prototypový servis - S / S za 24 hodin, 4 - 8 let v 48-96 pracovních hodinách.

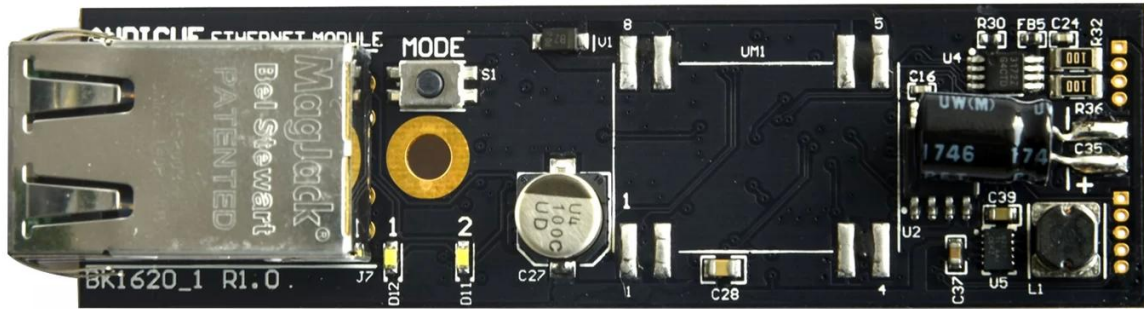
MĚSÍČÍ ŠTÍTKY MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLY NESMÍ BÝT PLUGGOVANÉ

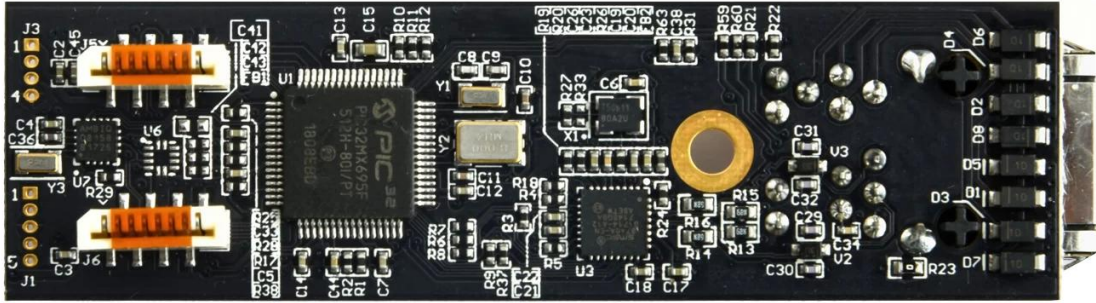
Balení s bezbarvou průhlednou bublinkovou fólií, 25 ks PCS / sáček, vložení vysoušeče do boků, vložení ukazatele vlhkosti na horní stranu

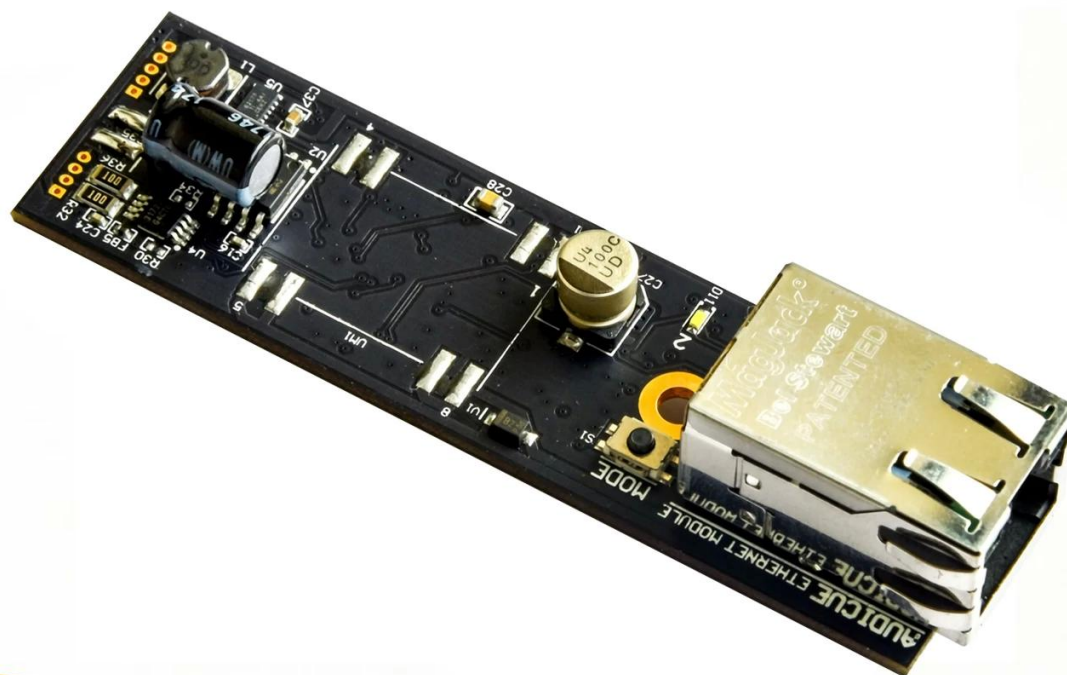
PROSÍM KLIKNĚTE TYTO PRO VÍCE INFORMACÍ [Halogen Výrobce PCB v Číně](#)

popis produktu

PCB P / N	T002_EthModule
Počet vrstev	4L
Materiál	FR-4 TG135
Deska thk	1,6 mm
měděný thk	1/1/1 / 1oz
Nejmenší velikost díry	0,3 MM
Počet otvorů (ks)s	218
řádek w /s	5 / 5mil
Kontrola impedance. Y / N (Tol%)	Y / 100 +/- 10% Ω
Povrchová úprava: Zlacené tvrdé zlato, Au	0,05 až 0,10UM
Pájecí maska Silkscreen	Modrá bílá
Velikost jedné desky	Rozměr X (mm): 80, rozměr Y (mm): 22,6
Panelizace	Dim X (mm): 90; Dim Y (mm): 121;
Speciální: odlupovatelná maska	N
Směrování / děrování	CNC + V-CUT







www.o-leading.com

RoHs Compliance výrobce Čína

Náš tým





Certifikace



201726 ZPMV2.E490354 - Wiring, Printed - Component

UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [ICD Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.
[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4490354
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Type	Cond Width			SS/ DS/	Area Diam	Max		Flame	Meets	C	
	Min	Cond	Edge			Solder	Diper				
	Min	Cond	Edge	DS/	Diam	Solder	Diper	Flame	Meets	C	
	min(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I
Hullayer (mass laminate) printed wiring boards.											
D-LEADING-401											
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
D-LEADING-407											
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	130	V-0	NI	-
Hullayer printed wiring boards.											
D-LEADING-408											
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	10	130	V-0	NI	'
Single layer printed wiring boards.											
D-LEADING-002											
	0.76 (0.03)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-
D-LEADING-003											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
D-LEADING-033											
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-
D-LEADING-205											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-
D-LEADING-206											
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Molding: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.
Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)

SGS

Test Report No. CAVEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID Description**
S/N1 CA18-051647.001 Green PCB*

Remarks:

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) * = Not Regulated

Rohs Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det?
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND

Member of the SGS Group (SGS SA)

Balení a balení dodávka

detaily balení	16 let profesionální výrobce PCB desek
Detail dodávky	7-12 dní



FAQ

1. Jak zajistit kvalitu O-Leading? [\[Výrobce motorového modulu motoru Čína\]](#)

Náš vysoký standard kvality je dosažen následujícím způsobem.

1. Proces je přísně kontrolován podle norem ISO 9001: 2008.
2. Extenzivní využití softwaru při řízení výrobního procesu
3. State-of-art zkušební zařízení a nástroje. Např. Létající sonda, rentgenová kontrola, AOI (automatizovaný optický inspektor) a ICT (testování v obvodu).
4. Dedicated týmu pro zajištění kvality s procesem analýzy případů selhání
5. Průběžná školení a vzdělávání zaměstnanců

2. Jak vaše O-Leading udržuje vaši konkurenceschopnou cenu?

Za poslední desetiletí se ceny mnoha surovin (např. Mědi, chemikálií) zdvojnásobily, ztrojnásobily nebo zvýšily na čtyřnásobek; Čínská měna RMB zhodnotila 31% oproti americkému dolaru; Výrazně vzrostly také naše náklady práce. Nicméně, O-Leading udržuje naše ceny stabilní. To zcela odpovídá našim inovacím v oblasti snižování nákladů, vyhýbání se odpadům a zvyšování efektivity. Naše ceny jsou v tomto odvětví velmi konkurenceschopné na stejné úrovni kvality.

Věříme v partnerství win-win s našimi zákazníky. Naše partnerství bude vzájemně prospěšné, pokud vám poskytneme výhodu v oblasti nákladů a kvality.

3. Jaké typy desek mohou O-Leading proces?

Společné desky FR4, vysoce TG a bezhalogenové desky, Rogers, Arlon, Telfon, desky na bázi hliníku / mědi, PI atd.

4. Jaká data jsou potřebná pro výrobu PCB?

Nejlepší je poskytovat data ve formátu Gerber 274-X. Navíc mohou být zpracovány také Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP a Eagle.

5. Jaký je typický procesní proces pro vícevrstvou desku plošných spojů?

Řezání materiálu → Vnitřní suchý film → vnitřní leptání → Vnitřní AOI → Vícenásobné → vrstvení vrstev Lisování → Vrtání → PTH → Pokovování panelů → Vnější suchý film → Pokovování → Vnější leptání → Vnější AOI → Pájená maska → Značka součásti → Povrchová úprava → Směrování → E / T → Vizuální kontrola.